

# Produktdatenblatt

hm2.0 unteres Schirmblech Bauform B19,  
Art. Nr. 244-23600-1

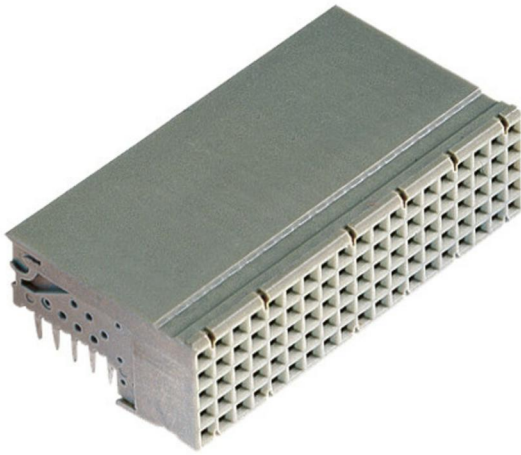


Abbildung ähnlich



Rechtwinklig



Einpresstechnik

- 19 Kontakte
- Anschlusslänge 3.4 mm
- für min 1.44 mm Leiterplattendicke
- getestet nach IEC 61076-4-101



» zum Produkt auf [www.ept.de](http://www.ept.de)



» zur Produktgruppe hm 2.0

# Produktdatenblatt

hm2.0 unteres Schirmblech Bauform B19,  
Art. Nr. 244-23600-1



## Technische Daten

### Grundlagen

Spezifikation	IEC 61076-4-101
Gütestufe	2
Anzahl Kontakte	19
Anschluss technik	Einpresstechnik
Anschlusslänge	3.4 mm
Betriebstemperatur	-55°C bis +125°C

### Material

Kontaktmaterial	Bronze
-----------------	--------

### Mechanisch

Rastermaß	2.0 mm
Steckkraft pro Kontakt	Abschirmung: max. 1 N
Ziehkraft pro Kontakt	Abschirmung: min. 0.15 N
Lebensdauer	> 250 Steckzyklen

### Elektrisch

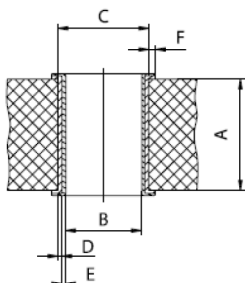
Betriebsstrom	1.5 A @ +20°C, 1.0 A @ +70°C
Durchgangswiderstand	max. 20 mΩ
Isolationswiderstand	min. 10 <sup>4</sup> MΩ
Prüfspannung	750 V r.m.s
Datenübertragung	3.125 Gbit/s

### Zulassungen / Konformität

Umwelt	RoHS konform
--------	--------------

### Lochspezifikation

Schichtaufbau nach IEC 60352-5



Material	chem. Sn Schicht
<b>Nennloch</b>	<b>Ø 0.6 mm</b>
<b>A Leiterplattendicke</b>	min 1.44 mm
<b>B Endloch</b>	Ø 0.60 ±0.05 mm
<b>C Grundbohrung</b>	0.70 ±0.02 mm
<b>D Cu Schicht</b>	min. 25 µm
<b>E Oberfläche</b>	max. 1.5 µm; chem. Sn Leiterplatten
<b>F Restring</b>	min. 0.1 mm

Material	Ni, Au Leiterplatten
<b>Nennloch</b>	<b>Ø 0.6 mm</b>
<b>A Leiterplattendicke</b>	min 1.44 mm
<b>B Endloch</b>	Ø 0.60 ±0.05 mm
<b>C Grundbohrung</b>	0.70 ±0.02 mm
<b>D Cu Schicht</b>	min. 25 µm
<b>E Oberfläche</b>	Ni, Au Schicht, 0.05 - 0.2 µm Au über 2.5 - 5 µm Ni
<b>F Restring</b>	min. 0.1 mm

Material	rein Cu Leiterplatten
<b>Nennloch</b>	<b>Ø 0.6 mm</b>
<b>A Leiterplattendicke</b>	min 1.44 mm
<b>B Endloch</b>	Ø 0.60 ±0.05 mm
<b>C Grundbohrung</b>	0.70 ±0.02 mm
<b>D Cu Schicht</b>	min. 25 µm
<b>E Oberfläche</b>	OSP*, z.B. GLICOAT-SMD (F2) mit 0.12 - 0.15 µm
<b>F Restring</b>	min. 0.1 mm

Material	HAL Sn Leiterplatten
<b>Nennloch</b>	<b>Ø 0.6 mm</b>
<b>A Leiterplattendicke</b>	min 1.44 mm
<b>B Endloch</b>	Ø 0.60 ±0.05 mm
<b>C Grundbohrung</b>	0.70 ±0.02 mm
<b>D Cu Schicht</b>	min. 25 µm
<b>E Oberfläche</b>	HAL Sn, 5 - 15 µm
<b>F Restring</b>	min. 0.1 mm

# Produktdatenblatt

hm2.0 unteres Schirmblech Bauform B19,  
Art. Nr. 244-23600-1

---



## Zeichnungen

Die Kundenzeichnung zu diesem Produkt erhalten Sie auf Anfrage unter [sales@ept.de](mailto:sales@ept.de)